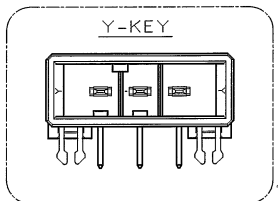
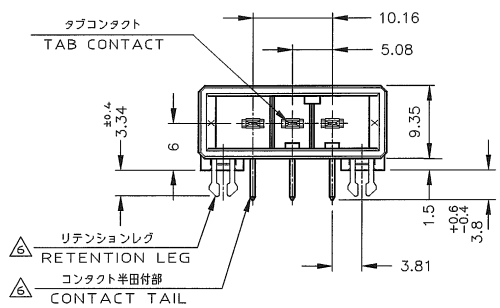
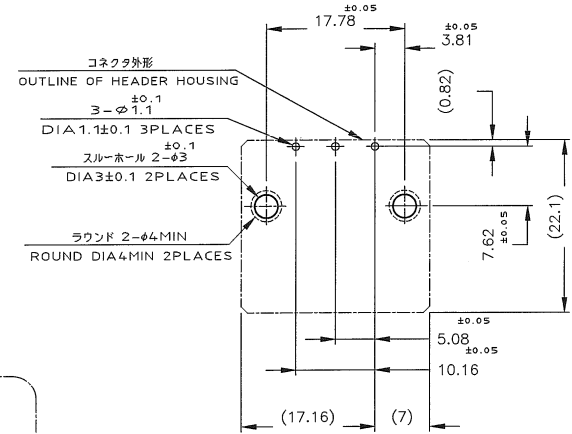
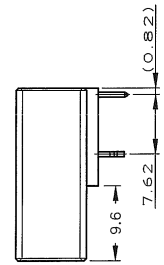
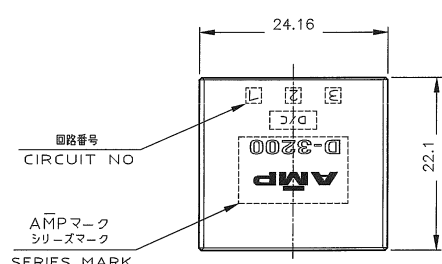


NUMBER 178138

METRIC

PRINT DET

3/8 ANGLE PROJECTION



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- 1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
- CONTACT: COPPER ALLOY
- RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △ FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △ FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
- コンタクト: 銅合金
- リテンションレグ: 銅合金
- △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- △ めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
- △ めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部

△	△	2-178138-5	Y
△	△	2-178138-3	Y
△	△	2-178138-2	Y
△	△	1-178138-5	X
△	△	1-178138-3	X
△	△	1-178138-2	X
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)	KEY	

		STE TE Connectivity	
WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME
mm*AWG -)		mmφ	3 POS SINGLE ROW
MATERIAL SEE NOTE		FINISH SEE NOTE	HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200
注記参照		注記参照	SIZE LOC NUMBER
		A3 J C=178138	
DR. 20/MAR/95 K.IKEDA		DE. 20/MAR/95 K.IKEDA	
CHK. 23/MAR/95 S.MANABE		APP. 23/MAR/95 S.MANABE	
E1 REVISED PER ECO-11-005030		LTR REVISION RECORD	
RKH		HMR (ZMARK)	
DR		CHK DATE	
E1		REV. E1	
SHEET		1 OF 1	